

公司代码：688620

公司简称：安凯微

# 广州安凯微电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要



## 第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

### 2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“四、风险因素”部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

### 7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本392,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利11,760,000.00元(含税)。本年度公司现金分红总额占2023年度归属于上市公司股东净利润的43.81%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。上述事项已获公司第二届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

#### 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	安凯微	688620	不适用

#### 公司存托凭证简况

适用 不适用

#### 联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	李瑾懿	曾丽美
办公地址	广州市黄埔区博文路107号	广州市黄埔区博文路107号
电话	020-32219000	020-32219000
电子信箱	ir@anyka.com	ir@anyka.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### 2.1 主要业务、主要产品或服务情况

##### （1）主营业务

公司主要从事物联网智能硬件核心 SoC 芯片的研发、设计、终测和销售，主要产品包括物联网摄像机芯片和物联网应用处理器芯片，产品广泛应用于智能家居、智慧安防、智慧办公和工业物联网等领域。

公司物联网摄像机芯片下游应用主要为家用摄像机和安防摄像机。公司物联网应用处理器芯片的下游应用包括楼宇可视对讲、智能门禁/考勤、智能锁、HMI 网关、工业显控屏等。

##### （2）主要产品及服务

###### 1) 公司产品概览

公司的主要产品物联网摄像机芯片和物联网应用处理器芯片均属 SoC 芯片。SoC 芯片通常集成了 CPU、系统控制外设接口、人机接口等，并包含完整的操作系统。针对不同的下游应用领域，SoC 芯片还需要集成特定的功能 IP，内部结构复杂，对芯片设计以及软硬件协同开发技术要求较

高。与单功能芯片相比，SoC 芯片集成度高、架构复杂，是当前集成电路设计研发的主流方向之一，是各类电子终端设备运算及控制的核心部件。

公司设计的物联网智能硬件核心 SoC 芯片除常用 IP 外，还集成了 ISP、视频编解码器、音频编解码器、加密模块、存储模块等多个功能 IP，是物联网智能终端的主控芯片，负责智能终端的数据运算以及周边元器件的控制与管理。在人工智能迅速发展的大趋势下，公司部分芯片集成 NPU，助力终端产品实现“智能化”，向智能物联网（AIoT）的大方向继续迈进。

公司依托长期、雄厚的技术积淀和持续的技术创新形成了物联网摄像机芯片和物联网应用处理器芯片两条主要的产品线。

## 2) 物联网摄像机芯片

公司现有物联网摄像机芯片分为第二代、第三代与第四代系列等，主要应用于家用摄像机、安防摄像机、婴儿监视器等物联网摄像机产品中。随着人工智能技术的持续推广和应用以及边缘智能化的发展趋势，第四代系列芯片进一步集成神经网络处理器（NPU），具备轻量级算力，支持人形检测和人脸识别等算法。该产品在 2023 年度大量出货，广受市场认可。第二代、第三代系列芯片凭借“PPA”的良好平衡、ISP 处理能力、功耗低等特点，在客户端的认可度持续提升，继续担当公司报告期内销售的主力。第四代系列单芯片支持双目芯片推出后也取得了市场的认可。

## 3) 物联网应用处理器芯片

公司物联网应用处理器芯片包括 HMI 芯片和 BLE 芯片，主要应用于楼宇可视对讲、智能门禁考勤、HMI 网关和智能门锁等产品。

### ①HMI（Human-Machine Interface，人机交互）芯片

公司第三代应用处理器 HMI 芯片，凭借高集成度、低功耗以及较强的图形加速性能，在楼宇可视对讲和智能门禁考勤领域开拓了众多客户。该类产品基于市场需求和技术的持续迭代，已经推出第四代芯片系列，在 CPU 运算处理、图像编解码能力、功耗和音频等性能指标上逐渐提升，产品的竞争力持续巩固。

公司部分 HMI 芯片达到了工业级芯片的使用标准，具有使用寿命较长、可靠性高和不良率低等特征，设计难度大于消费电子类产品的芯片，部分已经应用于工业显控屏终端设备，未来在工业芯片领域的国产替代前景向好。

### ②BLE（Bluetooth Low Energy，低功耗蓝牙）芯片

公司第一代 BLE 应用处理器芯片系列，支持低功耗蓝牙（BLE）、具有指纹识别加速器、屏幕

显示、语音播报、MIC 录音等功能，有效减少功耗，支持多种连接方式，主要应用于智能门锁产品。

2023 年，公司推向市场的第二代 BLE 应用处理器芯片系列采用了 40nm 工艺制程，进一步降低功耗水平、提高集成度，将指纹识别算法、RFID、触摸按键等模块集成在单一硅片上，实现多功能合一，有效降低下游智能门锁厂商的开发成本和生产成本，助力其提升产品市场竞争力。

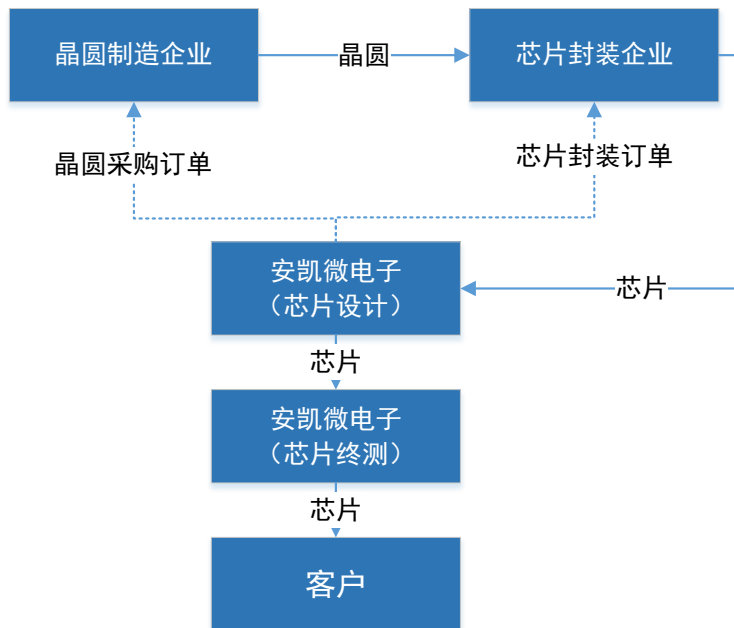
#### 4) 其他

公司内部设立了智能锁产品线，基于安凯微芯片为下游厂商提供包括半自动、全自动及多种开锁模式在内的智能锁完整的软硬件解决方案。下游客户可基于自身需求采购安凯微的一颗或多颗芯片，也可以采购基于安凯微芯片的模块级产品。随着公司第二代 BLE 应用处理器芯片的迭代升级完成，一些新项目已进入应用推广阶段。

## 2.2 主要经营模式

### (1) 盈利模式

公司采用“Fabless+芯片终测”的经营模式，专注于物联网智能硬件核心 SoC 芯片的研发、设计、终测和销售环节。公司芯片制造过程中的晶圆制造、芯片封装分别由晶圆制造企业、封装企业代工完成。公司取得代工后的芯片将对其终测，并将通过测试的芯片销售给客户，获得收入、现金流和利润。公司的经营模式具体如下：



## **(2) 采购模式和生产模式**

公司芯片研发设计完成后，通过向晶圆制造企业采购定制加工生产的晶圆，向芯片封装企业采购芯片封装服务来完成芯片的生产。

公司运营部根据市场部、销售部提出的销售预测和库存量制定相应的采购计划和生产计划，并向晶圆制造企业下达生产订单；晶圆制造企业在完成晶圆生产后将其发往封装企业进行芯片的封装；封装企业完成封装后将芯片成品发送至公司；公司运营部对芯片成品进行终测，通过终测的芯片成品才能够发往客户。此外，公司还外采了存储、PHY 等芯片，用于公司部分芯片的配套封装，提高芯片的集成度。

在采购和委外生产方面，公司制定了《芯片外包供应商认证流程及标准》《芯片外包生产流程规范》等完善的采购和委外生产管理制度。公司结合供应商的工艺技术、产能、质量、价格、交期等因素综合评定审核，确定合格供应商。

在芯片终测方面，公司自主开发测试系统，制定了完善的质量控制和溯源规则，能够有效提升芯片测试效率和成功率，进一步保障公司产品质量。

## **(3) 销售模式**

公司产品采用“经销、直销相结合”的销售模式。

直销模式下，公司和品牌商、方案商等客户签署销售协议。上述客户与公司协商产品价格、数量后直接向公司下订单，并由公司向其提供售后服务和技术支持。

经销模式是芯片行业常见的销售模式。经销商模式下，公司与经销商采用买断式经销模式。经销商根据下游客户的需求向公司下单，并以买断的形式向公司采购产品。经销商通过多年运营在行业内积累了丰富的客户资源和行业信息，一方面可以帮助公司快速建立销售渠道，扩大市场份额；另一方面可以提供部分技术支持。

## **(4) 研发模式**

鉴于公司主要产品 SoC 芯片集成度较高，公司采用了多部门联合研发模式，由项目管理委员会、市场部、产品部、研发部门等多个部门共同参与，其中项目管理委员会是公司研发项目管理的最高机构，负责项目的决策评审、项目变更及项目资源协调。

## 2.3 所处行业情况

### (1) 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务为物联网智能硬件核心 SoC 芯片的研发、设计、终测和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”(代码：6520)，细分行业为芯片设计行业；根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”；根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016 版)，公司产品属于“1 新一代信息技术产业—1.3 电子核心产业—1.3.1 集成电路—集成电路芯片产品”，根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》，公司属于“1 新一代信息技术产业—1.3 新兴软件和新型信息技术服务—1.3.4 新型信息技术服务(6520 集成电路设计)”，根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2024 年本)》，公司所属的集成电路设计行业属于鼓励类产业；公司主要从事物联网智能硬件核心 SoC 芯片的设计研发，属于国家重点支持的领域。

近年来，集成电路产业实现了快速发展。根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)统计，全球集成电路行业市场规模由 2013 年的 2,518 亿美元增长至 2022 年的 4,744 亿美元，复合年均增长率为 7.29%。根据中国半导体行业协会统计，我国集成电路行业销售规模从 2013 年的 2,509 亿元增长至 2022 年的 12,006 亿元，复合年均增长率为 19.00%；2022 年，中国集成电路产业销售额达到 12,006 亿元，同比增长 14.80%。根据市场研究机构 IMARC 集团统计，2022 年全球 SoC 芯片市场规模达到 1,638 亿美元，预计到 2028 年市场将达到 2,600 亿美元。近年来，随着 5G、物联网、人工智能、大数据等技术的成熟和普及，物联网智能硬件在形态、功能、性能等方面得到大幅度提升，传统关于视频和音频的多媒体处理算法需要与深度学习算法融合，并在 SoC 芯片体系架构上创新，加之人工智能大模型的发展，对边缘端中小算力终端、中小模型的发展带来了全新的机会，为公司聚焦的 SoC 芯片带来了大量的市场需求和空前的发展机遇。根据前瞻产业研究院初步测算，2022 年我国智能硬件行业规模达 0.93 万亿元。结合行业发展趋势及宏观环境因素并按照中性预测，智能硬件终端市场的需求将会进一步被打开，2023-2028 年中国智能硬件行业市场规模将会保持较快发展，按照 20%左右的年均复合增长率预计，2023 年中国智能硬件市场规模会达到万亿元级别，到 2028 年中国智能硬件行业的市场规模将会达到 2.78 万亿元。

随着物联网、人工智能和电子终端的普及，SoC 芯片已经成为当前集成电路设计研发的主流方向之一。SoC 芯片具有集成度高、功能复杂等特点，是各类电子终端设备运算及控制的核心部件，是决定下游应用产品性能、功能、价格的核心部件。SoC 芯片硬件规模庞大，单芯片的晶体管数量达到百万级至千亿级。

SoC 芯片的设计与制造涉及诸多专业技术领域，需要深厚的技术积累、精密的工艺控制以及高效的团队协作，这些都是 SoC 芯片技术门槛的重要组成部分。随着技术演进，这些门槛还在不断提高。SoC 芯片设计的复杂性高，需要在一个单芯片上集成 CPU、DSP、存储控制器、I/O 接口、电源管理模块以及其他多种功能模块，且选择合适的 IP 核并将其无缝集成到设计中也是一项不小的技术挑战；需要软硬件协同设计，确保软件栈能高效运行在高度定制化的硬件平台上，需要极其严谨的验证流程，包括逻辑验证、功能验证、性能验证、功耗验证等，确保芯片在上市前就达到预期的性能指标；需要开发专门的测试方案应对功能测试和故障诊断，确保所有模块都能正确无误地工作。设计一款高性能 SoC 芯片所需的研发投入大，包括人力、物力及时间成本，往往需要长时间的市场调研、设计、流片、验证等多个环节。

## **(2) 公司所处的行业地位分析及其变化情况**

公司是国内领先的芯片设计企业之一，主要从事物联网智能硬件 SoC 芯片的研发、设计、终测和销售，是国家级高新技术企业、专精特新“小巨人”企业、知识产权优势企业。公司 SoC 芯片具有集成度高、晶粒面积小、功耗低、功能全面等特点。公司凭借多年自主研发创新和技术积淀，公司 SoC 芯片中 IP 自主可控程度高，拥有 60 多类电路设计 IP，形成了 SoC 技术、ISP 技术、视频技术、机器学习技术等 7 大类核心技术，保证公司芯片能够顺利实现迭代升级的同时，形成了完善的知识产权体系，在行业内形成了较高的技术壁垒。公司芯片曾分别获得广东省科技进步奖、第十四届(2019 年度)中国半导体创新产品和技术奖、第十六届“中国芯”优秀市场表现产品和 2023 年度优秀创新产品奖等奖项。

公司物联网摄像机芯片下游应用主要为家用摄像机和安防摄像机。公司物联网摄像机芯片已经进入中国移动、中国联通、TP-LINK、涂鸦智能、摩托罗拉、广州九安等知名客户供应链。

公司物联网应用处理器芯片在智能家居、智慧办公领域，如楼宇对讲、智能门禁/考勤等细分市场也具有较强的竞争力，已经应用于熵基科技、安居宝、厦门立林、宁波得力、福州冠林等众多知名终端品牌。随着公司在智能锁市场的持续投入，公司的物联网应用处理器芯片陆续进入德施曼、凯迪仕、浙江公牛等知名品牌供应链。

## **(3) 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势**

### **1) AI 加速赋能，带动智能硬件技术更迭**

全球智能硬件市场正处在稳定且快速的增长阶段，技术创新、网络基础设施建设、消费需求升级共同驱动这一趋势的发展。芯片、传感器、通信技术、云平台、大数据以及人工智能等领域



的发展有效支撑了智能硬件市场的成长。随着人工智能技术的持续推广、大算力大模型的快速发展，边缘端中小模型、中小算力需求持续旺盛，智能硬件的需求日益增长，应用领域越来越广泛，包括智能家居、智慧安防、智能穿戴设备、智慧办公等。根据前瞻产业研究院给出的中性预测，到 2026 年中国智能硬件的市场规模有望达到 2 万亿元人民币。

人工智能加速赋能，带动智能硬件核心技术更迭。物联网摄像机芯片将朝着超高清化、智能化、XR 化发展，物联网应用处理器芯片将朝高集成度、低功耗并提升可靠性和抗干扰能力发展。随着物联网应用产品呈现侧边智能化趋势，市场对于物联网智能硬件核心 SoC 芯片的音视频图像处理能力、算力、无线连接能力、功耗等要求不断提高。芯片供应商必须根据不同类别芯片的市场需求变动和技术水平发展对现有技术进行升级迭代，以保持技术和产品的竞争力。

随着芯片集成度、运算能力的不断提高，对于芯片封装、工艺制程的要求也不断提升。公司作为物联网智能硬件核心 SoC 的芯片设计公司，坚持不断创新，推进物联网领域芯片制程升级。目前公司量产产品工艺已迭代至 22nm，部分带有轻量级算力，晶粒面积更小，集成度更高、功能更全面，动态及待机功耗方面进一步降低。公司采用更先进制程的芯片也已经在研发中，以持续满足未来市场和产品发展的要求。

## 2) 工业级芯片前景广阔，智能门锁行业发展稳健

工业级芯片相对于消费级芯片在可靠性、安全性、稳定性上都有着更高的要求。随着物联网技术的快速发展，使得工业级芯片具备了互联互通能力，实现了设备自动化和智能化、设备连接与数据共享。同时，人工智能的兴起促进了工业级芯片向智能化和自适应性方向发展，加速向智能制造的推进。

中国作为全球制造业大国，特别是智能制造、工业互联网等领域的发展，对工业级芯片的需求旺盛。针对国内目前工业级芯片的供应商格局，国产工业芯片存在巨大的市场空间。公司也在工业级芯片领域进行了积极的研发布局，且已有产品应用于工业等级终端设备（如工业设备显控终端等）。工业级产品的布局，无论对于技术的提升还是市场拓展都具有重大的意义。

近年来，作为智能家居中的新势力，智能门锁的发展呈现了积极向上的态势。智能门锁的出现为消费者带来了更高的安全性、便利性和智能化体验。当前，中国智能门锁行业处于发展前期阶段，具有渗透率低、成长性高、市场潜力大等特点。根据全国五金工业信息中心数据显示，2023 年全国智能门锁产销量数据约 2,230 万套，同比增长约为 12.7%。智能门锁由于安全性、稳定性等要求，其产品要求逐渐向准工业级、工业级发展，其功能要求也越来越丰富，对于 SoC 芯片的需求越来越旺盛。安凯微可以提供目前市面上最全功能的智能锁解决方案和全系列核心芯片。

### 3) 大力发展新质生产力

新质生产力的提出，旨在在传统生产力的基础上通过技术创新、制度创新、管理创新等带来生产力质的飞跃。新质生产力的核心是技术创新，通过高新技术的广泛应用，如人工智能、大数据、云计算、物联网、生物科技、新能源、新材料等领域的前沿科技转化为先进生产力，提升生产效率和产品质量，降低能耗和环境污染，实现高质量发展。在全球竞争格局下，拥有新质生产力意味着在国际分工中占据更有利的位置，有助于国民经济的发展。

随着新质生产力这一重要概念的提出，各级政府对包括新一代信息技术、人工智能、智能装备、物联网在内的多种新兴战略产业的支持力度进一步加大，旨在实现新一代信息技术、先进制造技术、新材料等技术的融合应用，孕育出更智能、更高效、更低碳、更安全新型生产工具，促进产业结构向高端化、智能化转变。在政策引导下，集成电路、人工智能等正逐渐成为推动传统产业升级的重要引擎，不仅对于国民经济的发展具有重要的战略意义，也同时兼具重大的经济意义。

半导体产业是一个长期积累的行业，需要政府、行业、企业以及从事相关行业的个人经过多年不懈的努力才能取得长足的进步和实质性的突破。中国的半导体行业经过多年的发展，尤其是最近十年强有力的政策引导和各企业的齐心协力，已经在一些领域取得了一些优势发展。面对新质生产力的号召，半导体行业还需要继续推进，通过持续的技术创新，为信息技术的发展提供原动力。现阶段，我国半导体产业已经具有一些优势的环节，如集成电路设计等，应持续深化发展、扩大规模，带动产业链上下游持续进步，促进产业链完备，实现可控的发展。在人工智能等技术同步发展的推进下，随着各新兴领域的交叉融合与应用，将为半导体产业带来新的机遇并为终端应用提供更加强有力的助推力。

融合了新一代信息技术、集成电路、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备等新兴技术的新质生产力，将不断推动前沿科技和产业变革，助力中国经济实现高质量发展。而“中国芯”也将这一过程中大放异彩，展现出更加强大的生命力和竞争力。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	1,669,203,783.80	787,017,390.75	112.09	743,692,476.33
归属于上市公司股东的净资产	1,531,475,721.53	579,673,384.38	164.20	539,830,769.58

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
营业收入	572,528,232.73	508,898,248.67	12.50	514,812,456.16
归属于上市公司股东的净利润	26,843,386.42	39,842,614.80	-32.63	59,243,848.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,377,420.86	22,306,465.64	-66.93	47,222,450.29
经营活动产生的现金流量净额	18,245,724.87	-4,460,178.93	不适用	48,903,128.48
加权平均净资产收益率(%)	2.54	7.12	减少4.58个百分点	11.61
基本每股收益(元/股)	0.08	0.14	-42.86	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.14	-42.86	0.20
研发投入占营业收入的比例(%)	19.43	18.46	增加0.97个百分点	14.49

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	110,800,621.31	126,901,360.85	132,373,176.06	202,453,074.51
归属于上市公司股东的净利润	3,868,396.09	10,142,831.72	-266,390.80	13,098,549.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,007,325.58	8,621,713.42	-6,153,945.46	2,902,327.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,426,518.36	14,633,690.04	-56,991,967.33	62,030,520.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）相关规定，公司将与资产相关的投资补贴政府补助 330,743.58（税前）认定为经常性损益。

## 4 股东情况

### 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,792
------------------	--------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)	15,235							
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数 (户)	0							
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数 (户)	0							
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包 含 融 借 股 的 售 份 量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
安凯技术	0	61,382,160	15.66	61,382,160		无	0	境 外 法人
武义凯瑞达	0	28,420,840	7.25	28,420,840		无	0	境 内 非 国 有 法 人
Primrose Capital	0	25,015,760	6.38	25,015,760		无	0	境 外 法人
胡胜发	0	18,942,000	4.83	18,942,000		无	0	境 外 自 然 人
科金控股	0	17,247,160	4.40	17,247,160		无	0	国 有 法人
凯金投资	0	17,070,760	4.35	17,070,760		无	0	其他
富成投资	0	16,482,200	4.20	16,482,200		无	0	境 内 非 国 有 法 人
小米产业基金	0	13,137,600	3.35	13,137,600		无	0	其他
越秀智创	0	8,076,600	2.06	8,076,600		无	0	其他
越秀金蝉二期	0	8,076,600	2.06	8,076,600		无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>注 1：胡胜发及其一致行动人包括胡胜发、安凯技术、武义凯瑞达、凯安科技和凯驰投资，合计控制公司 29.95%股份的表决权。</p> <p>注 2：凯金投资的执行事务合伙人科华创业可以对凯得瞪羚产生重大影响，凯金投资与凯得瞪羚存在一致行动关系。</p> <p>注 3：越秀智创和越秀金蝉二期的执行事务合伙人为广州越秀产业投资基金管理股份有限公司。</p> <p>注 4：公司未知以上其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

**存托凭证持有人情况**

适用 不适用

**截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

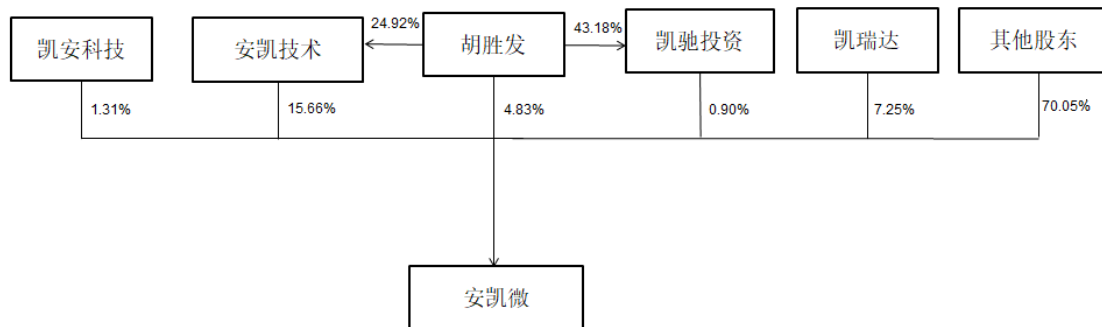
适用 不适用

**4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用

**4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



注1：安凯技术是安凯微第一大股东，胡胜发持有安凯技术24.92%股权，其配偶马思捷持有安凯技术0.39%股权，两人合计持有安凯技术25.31%股权，胡胜发与安凯技术股东李雪刚、XIAOMING LI签署了一致行动协议，胡胜发控制安凯技术；  
 注2：胡胜发为凯驰投资执行事务合伙人，并持有凯驰投资43.18%财产份额，胡胜发控制凯驰投资。  
 注3：胡胜发之妹胡华容持有武义凯瑞达81%股权，胡华容为武义凯瑞达实际控制人。  
 注4：胡胜发分别与安凯技术、凯驰投资、凯安科技、武义凯瑞达签署了一致行动协议，就公司相关事项表决时保持一致，如不能达成一致，以胡胜发的意见为准。胡胜发及其一致行动人包括胡胜发、安凯技术、武义凯瑞达、凯安科技和凯驰投资，合计控制公司29.95%股份的表决权。

**4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况**

适用 不适用

**5 公司债券情况**

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 57,252.82 万元，较上年同期增长 12.50%；归属于上市公司股东的净利润 2,684.34 万元，较上年同期减少 32.63%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 737.74 万元，较上年同期减少 66.93%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用